

# 硅系导热凝胶 TD2000

## Silicone Thermal Conductive Gap Filler TD2000

### 产品概述

TD2000 是双组分硅系液态导热凝胶，产品按 1:1 比例混合后具有良好的触变性和低粘度，当受到外力作用时可以很容易填充到发热器件表面及周边缝隙中与散热片形成导热膜桥。

产品在室温固化或者高温加速固化后，具有良好的弹性模量，协助缓解发热器件因发热后热膨胀释放的应力，保护元器件不受损伤，易于在器件上一体剥离，方便客户重工。可典型应用于电动汽车电池组、汽车电子设备、LED 照明、主机和小型办公室网络设备、大型存储设备及智能手机模块和消费电子等产品中。

### 固化前产品特性

外观	A 白色/B 浅黄色粘稠液体
粘度 (Brookfield CP52, mPa.s(cP))	400000
密度(ASTM D792.g/cm <sup>3</sup> )	2.9
混合比例	1:1
挤出速率 (2mm 针头 90psi , g/min)	>40
储存条件 (<25°C, months)	6

### 产品固化条件

操作时间@25°C, min	30
固化时间@25°C, h	5
加速时间@100°C, min	10

### 固化后产品特性

项目	测试方法	单位	数值
导热系数	ASTM D5470	W/mK	2.0
体积电阻	ASTM D257	Ohm-meter	10 <sup>13</sup>
硬度 (shore 00)	ASTM D2240	--	50
阻燃等级	UL94	--	V-0
操作温度	--	°C	-60-200

### 产品包装及货期

小包装	50CC、400CC、600CC 双液针管
大包装	20L 桶装
最小包装量 (MPQ)	50CC
最小订单量 (MOQ)	50CC
交货期 (L/T)	10-15 个工作日
常温快速固化产品	可定制